



size: 109x158 mm

- EN Thermal compound (grease) for heatsinks**  
Helps the heat dissipation from a CPU, chipset or processor to a heatsink  
Excellent thermal impedance  
Perfect stability - will not separate, run, migrate, or bleed  
Non capacitive or electrically conductive
- DE Wärmleitpaste für Kühlkörper**  
Unterstützt die Wärmeableitung von der CPU oder dem Chipsatz zum Kühlkörper  
Läuft und tropft nicht  
Nicht kapazitiv oder elektrisch leitfähig
- NL Koelpasta voor gebruik i.c.m. PC koellichamen**  
Helpt om de warmte van een CPU, chipset of processor beter te geleiden naar een koellichaam  
Uitstekende thermische geleiding  
Uiterst stabiel- zal niet schiften, uitlopen of wegvloeien  
Niet elektrisch geleidend
- RU Термопаста для теплоотводов (радиаторов)**  
Помогает отводить тепло от процессоров, чипсетов к радиатору  
Отличная теплопроводность  
Прекрасная стабильность - не рассыпается, не вытекает  
Электрически непроводящая
- UA Термопаста для радіаторів**  
Допомагає відводити тепло від процесорів, чипсетів до радіатора  
Відмінна теплопровідність  
Прекрасна стабільність - не розсипається, не випливає  
Без електропровідності
- PL Pasta termoprzewodząca przeznaczona do scalania z radiatorami**  
Ułatwia odprowadzanie ciepła z procesora, chipsetu i procesora do radiatora  
Doskonała impedancja termiczna  
Zapewnia stabilność, doskonale scala, nie rozwarstwa się, nie utlenia.  
Nie przewodzi prądu elektrycznego
- FR Graisse pour radiateur des microprocesseurs ou composants**  
Facilite et optimise la dissipation de chaleur  
Grande stabilité thermique
- ES Compuesto térmico (grasa) de los disipadores de calor**  
Ayuda a la disipación de calor de la CPU, chipset o procesador con un disipador de calor  
Excelente impedancia térmica  
Estabilidad perfecta - no se separará, correr, migrar, o sangrar  
No capacitiva o eléctricamente conductora

#### SPECIFICATIONS

Color: grey  
Thermal conductivity:  
> 4.5 W / mK  
Thermal impedance < 0.205 °C  
-in2 / W  
Density: > 2.5  
Evaporation: < 0.001 %  
Volatility: < 0.005 %  
The dielectric constant: > 5.1  
Dissipation factor: < 0.005  
Viscosity: 76 CPS  
Thixotropic index: 310 °C ± 10 °C  
Operating temperature:  
- 50 °C - 240 °C  
Composites: 50 % silicone  
compounds  
Compounds: 30 % of carbon  
The compounds of metal oxides:  
20 %  
Weight: 3 g

proud to be a product of



[www.gembird.eu](http://www.gembird.eu)

Gembird Europe B.V.

Wittevrouwen 56, 1358CD Almere, The Netherlands



All brands and logos are registered trademarks of their respective owners.



P/N: TG-G3.0-01



MADE IN CHINA